OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

GLOB TOP-MATERIAALIT

Lämpökovetteiset

HYSOL® EO1016™
Thermal Cure Glob Top

- UV Cure Glob Top
- Kapselointimateriaali
- ECCOBOND™

TUOTEKUVAUS

Glob Top -materiaalit on suunniteltu herkkien elektroniikkakomponenttien, sirujen ja lankabondausliitosten suojaamiseen. Kapselointimateriaali annostellaan suoraan komponentin päälle, jossa se muodostaa suojaavan kerroksen ilman erillistä muottia tai ympäröivää rakennetta.

Lämpökovetteiset materiaalit tarjoavat hyvän sähköisen eristyksen sekä suojaa kosteudelta, kemikaaleilta, mekaaniselta rasitukselta ja lämpötilavaihteluilta. Tiksotrooppisten ominaisuuksiensa ansiosta materiaali pysyy hallitusti komponentin ja liitoslankojen ympärillä ennen kovettumista.

Glob Top -menetelmä soveltuu erityisesti Chip-on-Board-rakenteisiin, puolijohteisiin, ASIC-piireihin ja muihin elektroniikkakokoonpanoihin, joissa herkät liitokset tarvitsevat pitkäaikaista suojaa. Menetelmä mahdollistaa myös kompaktin rakenteen ja voi vähentää kapselointiprosessin työvaiheita.

Valikoimassa on useita lämpökovetteisia materiaaleja erilaisilla viskositeetti-, lämpötila- ja mekaanisilla ominaisuuksilla, joten sopiva kapselointimateriaali voidaan valita käyttökohteen ja valmistusprosessin vaatimusten mukaan.